

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

**江苏洪田科技股份有限公司**  
**2025 年半年度业绩说明会记录表**

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上投资者
时间	2025 年 9 月 8 日上午 11:00-12:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址: <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长：赵伟斌 总经理、董事会秘书：朱开星 财务总监：杨成虎 独立董事：高文进
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>主要交流问题及回复如下：</b></p> <p><b>1、注意到公司目前货币资金对流动负债的覆盖比例为 43.13%，且财务费用占比较高。请问管理层，如何改善现金流状况和偿债能力？另一方面，公司应收账款规模较大，打算如何加强回款管理，控制坏账风险？在未来战略投资和财务稳健之间如何平衡？</b></p> <p>答：您好，感谢您的关注。报告期内公司通过加强应收账款管理，显著提升了上半年经营现金流，当期经营活动现金流量净额较去年转正至 1.13 亿元，为业务扩张提供了充裕的现金储备。同时，公司在践行“内增外拓”的战略中，优选付款条件好、利润率高的订单，精选优质投资标的，通过优化债务结构来控制财务费用，以充足的货币资金来平衡战略投资与财务稳健，确保现金流安全、充裕。谢谢！</p> <p><b>2、公司上半年研发费用同比增长 123%，这在行业中非常突出。想了解这些研发投入具体集中在哪些技术项目上？目前诸如复</b></p>

合集流体设备、半导体光学设备等研发成果，预计何时能实现规模化销售并对业绩产生显著贡献？公司如何评估这些新技术产品的市场竞争力？

答：您好，感谢您的关注。公司研发费用增长主要投入在公司真空镀膜设备技术研发及高端光学相关设备的研发和投入。目前真空镀膜设备已于 2024 年实现部分量产，高端光学相关设备（掩模版、玻璃基板）已于 2025 年取得头部企业相关订单。

公司下属子公司洪田科技的“真空磁控溅射一体机”复合铜箔真空镀膜成套设备，是全国首家采用“一步法全干法”生产工艺的真空镀膜设备，其稳定传送超薄基材胶片技术与高速成膜圆筒旋转式磁控溅射阴极技术等多个关键技术，以及工艺便捷控制、环保节能、模块化设计等多方面均位居行业领先水平。

公司下属子公司洪镭光学生产的掩模版设备帮助客户大幅降低成本，实现了掩模版微纳光刻解决方案的国产替代，可满足先进封装与半导体掩模版领域产品的直写光刻需求。玻璃基板在热膨胀系数、信号传输损耗、化学稳定性、可布线密度等方面优于有机基板，尤其适配 AI 算力芯片封装、CPO 光模块、Mini-LED 等领域的应用，随着 TGV 技术与制程工艺的持续优化，有望替代有机基板成为先进封装领域的核心基材。谢谢！

**3、管理层好，2025年上半年公司营收同比下降 43.4%，净利润出现亏损。除了提到的下游去库存和宏观因素外，公司认为内部哪些方面亟需改善？未来一年，公司计划采取哪些具体措施来扭转局面？例如，在市场拓展、成本控制或新产品推广方面是否有明确的时间表和目标？**

答：您好，感谢您的关注。除了提到的下游去库存和宏观因素外，公司高端光学板块与超精密真空板块研发投入持续增大，具体原因详见公司披露的《2025 年半年度报告》。未来，公司将重点强化应收款管理，加强在手订单产品交付，持续推进高端电解铜箔装备与高端光学、超精密真空板块新产品推广，积极开

	拓国内外市场，加快实现扭亏为盈，经营业绩持续增长。同时公司始终坚定实施“内增外拓”的发展战略，按照既定的目标落实各项经营指标。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2025-9-8
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。